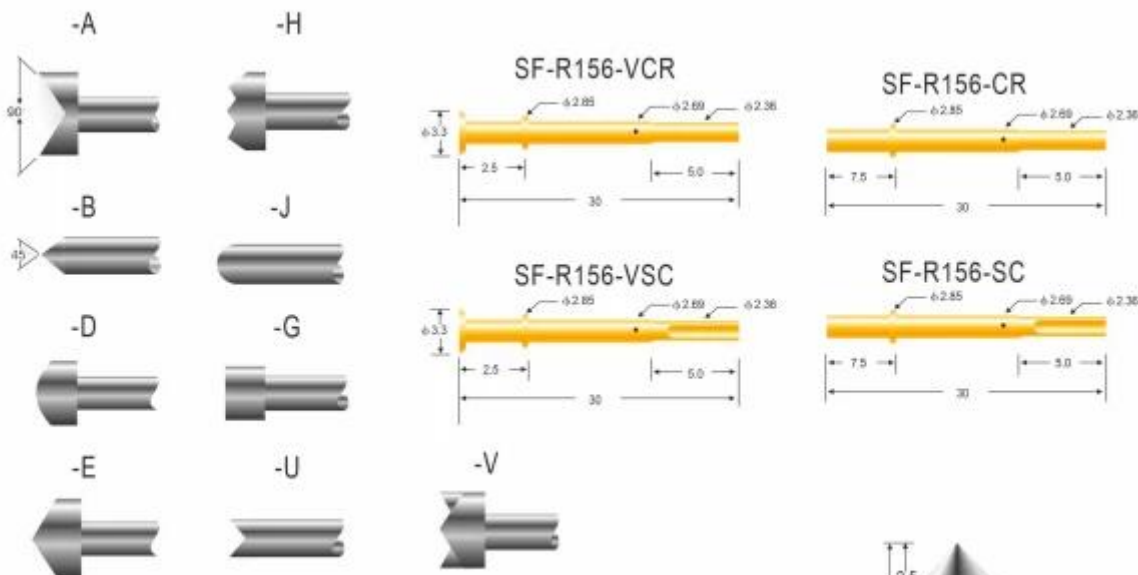


□□□□□□

SFENG 1984 精密探针 (ICT FCT) 探针 精密探针 探针

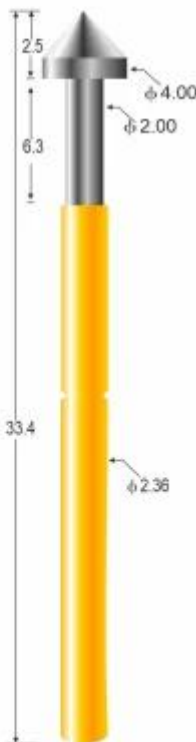
□□□□□



技术规格
PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	4.75mm(.1870 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 2.75mm(.1083 ") 电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102 ")
Full travel 行程	6.30(.2480 ")
Spring force 弹簧压力	250g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Brass, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	5A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)
Connections 接线形式	Crimp: R156-VCR,R156-CR Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



SF-P156-E

□□□□□□:

物料名称	SF-P156
规格	4*75mm*.1870"
厚度	厚度:2.75mm*.1083" 厚度公差:±0.05mm*.00196"
重量	6.30*.2480"
重量	250g
表面处理	铜锡合金Cu/Rh 无铅 环保
电压	5A
电阻	50mΩ
MOQ	100
备注	铜锡合金厚度7mm

技术要求

1. 铜锡合金厚度24mm
2. 铜锡合金厚度公差±0.05mm
3. 铜锡合金厚度公差±0.05mm
4. 铜锡合金厚度公差±0.05mm

材料要求

1. PCB ICT FCT 铜锡合金厚度公差±0.05mm;
 2. 铜锡合金厚度公差±0.05mm 2 铜锡合金厚度公差±0.05mm (铜锡合金)
 3. BGA 铜锡合金厚度公差±0.05mm
 4. 铜锡合金厚度公差±0.05mm QZ 铜锡合金 VZ 铜锡合金 LM 铜锡合金;
 5. 铜锡合金厚度公差±0.05mm;
 6. 铜锡合金厚度公差±0.05mm/铜锡合金;
 7. 铜锡合金厚度公差±0.05mm 30# OK 铜锡合金厚度公差±0.05mm POM 铜锡合金
- 铜锡合金厚度公差±0.05mm

其他要求





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



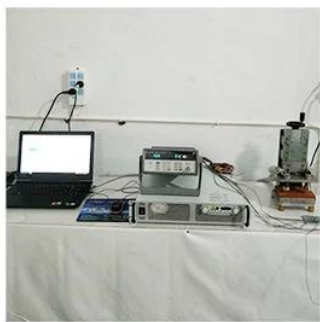
4. Quality inspection



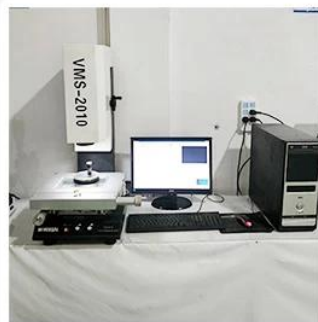
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請說明...

A1: 請說明...

Q2. 請說明...

A2: 請說明 QC 請說明... 1 請說明...

Q3. 請說明...

A3: 請說明...

Q4. 請說明...

A4: 請說明...

Q5. 請說明...

A5: 請說明...

Q6. 請說明...

A6: 請說明...

Q7. OEM 與 ODM 的區別?

A7: 請說明 OEM / ODM 的區別 . P 請說明...

Q8. 請說明...

A8: T/T 請說明 L/C 請說明 MOQ 請說明

請說明...

請說明 DHL UPS FedEx TNT EMS 請說明

請說明 Exwork FOB CNF CIF 請說明



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









□□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

